

## 印制电路词汇

www.smt.cn 作者:未知 来自:未知 点击:1560 时间:2003-11-4

### 一、综合词汇

- 1、 印制电路 : printed circuit
- 2、 印制线路 : printed wiring
- 3、 印制板 : printed board
- 4、 印制板电路 : printed circuit board (PCB)
- 5、 印制线路板 : printed wiring board(PWB)
- 6、 印制元件 : printed component
- 7、 印制接点 : printed contact
- 8、 印制板装配 : printed board assembly
- 9、 板 : board
- 10、 单面印制板 : single-sided printed board(SSB)
- 11、 双面印制板 : double-sided printed board(DSB)
- 12、 多层印制板 : multilayer printed board(MLB)
- 13、 多层印制电路板 : multilayer printed circuit board
- 14、 多层印制线路板 : multilayer printed wiring board
- 15、 刚性印制板 : rigid printed board
- 16、 刚性单面印制板 : rigid single-sided printed board
- 17、 刚性双面印制板 : rigid double-sided printed board
- 18、 刚性多层印制板 : rigid multilayer printed board
- 19、 挠性多层印制板 : flexible multilayer printed board
- 20、 挠性印制板 : flexible printed board
- 21、 挠性单面印制板 : flexible single-sided printed board
- 22、 挠性双面印制板 : flexible double-sided printed board
- 23、 挠性印制电路 : flexible printed circuit (FPC)
- 24、 挠性印制线路 : flexible printed wiring
- 25、 刚性印制板 : flex-rigid printed board, rigid-flex printed board
- 26、 刚性双面印制板 :  
flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed
- 27、 刚性多层印制板 :  
flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board
- 28、 齐平印制板 : flush printed board
- 29、 金属芯印制板 : metal core printed board
- 30、 金属基印制板 : metal base printed board
- 31、 多重布线印制板 : mult-wiring printed board
- 32、 陶瓷印制板 : ceramic substrate printed board
- 33、 导电胶印制板 : electroconductive paste printed board
- 34、 模塑电路板 : molded circuit board

- 35、 模压印制板 : stamped printed wiring board
- 36、 顺序层压多层印制板 : sequentially-laminated multilayer
- 37、 散线印制板 : discrete wiring board
- 38、 微线印制板 : micro wire board
- 39、 积层印制板 : build-up printed board
- 40、 积层多层印制板 : build-up multilayer printed board (BUM)
- 41、 积层挠印制板 : build-up flexible printed board
- 42、 表面层合电路板 : surface laminar circuit (SLC)
- 43、 埋入凸块连印制板 : B2it printed board
- 44、 多层膜基板 : multi-layered film substrate(MFS)
- 45、 层间全内导通多层印制板 : ALIVH multilayer printed board
- 46、 载芯片板 : chip on board (COB)
- 47、 埋电阻板 : buried resistance board
- 48、 母板 : mother board
- 49、 子板 : daughter board
- 50、 背板 : backplane
- 51、 裸板 : bare board
- 52、 键盘板夹心板 : copper-invar-copper board
- 53、 动态挠性板 : dynamic flex board
- 54、 静态挠性板 : static flex board
- 55、 可断拼板 : break-away panel
- 56、 电缆 : cable
- 57、 挠性扁平电缆 : flexible flat cable (FFC)
- 58、 薄膜开关 : membrane switch
- 59、 混合电路 : hybrid circuit
- 60、 厚膜 : thick film
- 61、 厚膜电路 : thick film circuit
- 62、 薄膜 : thin film
- 63、 薄膜混合电路 : thin film hybrid circuit
- 64、 互连 : interconnection
- 65、 导线 : conductor trace line
- 66、 齐平导线 : flush conductor
- 67、 传输线 : transmission line
- 68、 跨交 : crossover
- 69、 板边插头 : edge-board contact
- 70、 增强板 : stiffener
- 71、 基底 : substrate
- 72、 基板面 : real estate
- 73、 导线面 : conductor side
- 74、 元件面 : component side
- 75、 焊接面 : solder side
- 76、 印制 : printing

- 77、 网格 : grid
- 78、 图形 : pattern
- 79、 导电图形 : conductive pattern
- 80、 非导电图形 : non-conductive pattern
- 81、 字符 : legend
- 82、 标志 : mark
- 二、 基材 :

- 1、 基材 : base material
- 2、 层压板 : laminate
- 3、 覆金属箔基材 : metal-clad base material
- 4、 覆铜箔层压板 : copper-clad laminate (CCL)
- 5、 单面覆铜箔层压板 : single-sided copper-clad laminate
- 6、 双面覆铜箔层压板 : double-sided copper-clad laminate
- 7、 复合层压板 : composite laminate
- 8、 薄层压板 : thin laminate
- 9、 金属芯覆铜箔层压板 : metal core copper-clad laminate
- 10、 金属基覆铜层压板 : metal base copper-clad laminate
- 11、 挠性覆铜箔绝缘薄膜 : flexible copper-clad dielectric film
- 12、 基体材料 : basis material
- 13、 预浸材料 : prepreg
- 14、 粘结片 : bonding sheet
- 15、 预浸粘结片 : preimpregnated bonding sheet
- 16、 环氧玻璃基板 : epoxy glass substrate
- 17、 加成法用层压板 : laminate for additive process
- 18、 预制内层覆箔板 : mass lamination panel
- 19、 内层芯板 : core material
- 20、 催化板材 : catalyzed board , coated catalyzed laminate
- 21、 涂胶催化层压板 : adhesive-coated catalyzed laminate
- 22、 涂胶无催化层压板 : adhesive-coated uncatalyzed laminate
- 23、 粘结层 : bonding layer
- 24、 粘结膜 : film adhesive
- 25、 涂胶粘剂绝缘薄膜 : adhesive coated dielectric film
- 26、 无支撑胶粘剂膜 : unsupported adhesive film
- 27、 覆盖层 : cover layer (cover lay)
- 28、 增强板材 : stiffener material
- 29、 铜箔面 : copper-clad surface
- 30、 去铜箔面 : foil removal surface
- 31、 层压板面 : unclad laminate surface
- 32、 基膜面 : base film surface
- 33、 胶粘剂面 : adhesive face
- 34、 原始光洁面 : plate finish

- 35、粗面 : matt finish
- 36、纵向 : length wise direction
- 37、模向 : cross wise direction
- 38、剪切板 : cut to size panel
- 39、酚醛纸质覆铜箔板 :  
phenolic cellulose paper copper-clad laminates(phenolic/paper CCL)
- 40、环氧纸质覆铜箔板 :  
epoxide cellulose paper copper-clad laminates (epoxy/paper CCL)
- 41、环氧玻璃布基覆铜箔板 : epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
- 42、环氧玻璃布纸复合覆铜箔板 :  
epoxide cellulose paper core, glass cloth surfaces copper-clad laminates
- 43、环氧玻璃布玻璃纤维复合覆铜箔板 :  
epoxide non woven/woven glass reinforced copper-clad laminates
- 44、聚酯玻璃布覆铜箔板 : polyester woven glass fabric copper-clad laminates
- 45、聚酰亚胺玻璃布覆铜箔板 : polyimide woven glass fabric copper-clad laminates
- 46、双马来酰亚胺三嗪环氧玻璃布覆铜箔板 :  
bismaleimide/triazine/epoxide woven glass fabric copper-clad laminates
- 47、环氧合成纤维布覆铜箔板 :  
epoxide synthetic fiber fabric copper-clad laminates
- 48、聚四氟乙烯玻璃纤维覆铜箔板 : teflon/fiber glass copper-clad laminates
- 49、超薄型层压板 : ultra thin laminate
- 50、陶瓷基覆铜箔板 : ceramics base copper-clad laminates
- 51、紫外线阻挡型覆铜箔板 : UV blocking copper-clad laminates

### 三、基材的材料

- 1、A阶树脂 : A-stage resin
- 2、B阶树脂 : B-stage resin
- 3、C阶树脂 : C-stage resin
- 4、环氧树脂 : epoxy resin
- 5、酚醛树脂 : phenolic resin
- 6、聚酯树脂 : polyester resin
- 7、聚酰亚胺树脂 : polyimide resin
- 8、双马来酰亚胺三嗪树脂 : bismaleimide-triazine resin
- 9、丙烯酸树脂 : acrylic resin
- 10、三聚氰胺甲醛树脂 : melamine formaldehyde resin
- 11、多官能环氧树脂 : polyfunctional epoxy resin
- 12、溴化环氧树脂 : brominated epoxy resin
- 13、环氧酚醛 : epoxy novolac
- 14、氟树脂 : fluoro resin
- 15、硅树脂 : silicone resin
- 16、硅烷 : silane

- 17、 聚合物 : polymer
- 18、 无定形聚合物 : amorphous polymer
- 19、 结晶现象 : crystalline polymer
- 20、 双晶现象 : dimorphism
- 21、 共聚物 : copolymer
- 22、 合成树脂 : synthetic
- 23、 热固性树脂 : thermosetting resin
- 24、 热塑性树脂 : thermoplastic resin
- 25、 感光性树脂 : photosensitive resin
- 26、 环氧当量 : weight per epoxy equivalent (WPE)
- 27、 环氧值 : epoxy value
- 28、 双氰胺 : dicyandiamide
- 29、 粘结剂 : binder
- 30、 胶粘剂 : adhesive
- 31、 固化剂 : curing agent
- 32、 阻燃剂 : flame retardant
- 33、 遮光剂 : opaquer
- 34、 增塑剂 : plasticizers
- 35、 不饱和聚酯 : unsaturated polyester
- 36、 聚酯薄膜 : polyester
- 37、 聚酰亚胺薄膜 : polyimide film (PI)
- 38、 聚四氟乙烯 : polytetrafluoroethylene (PTFE)
- 39、 聚全氟乙烯丙烯薄膜 : perfluorinated ethylene-propylene copolymer film (FEP)
- 40、 增强材料 : reinforcing material
- 41、 玻璃纤维 : glass fiber
- 42、 E 玻璃纤维 : E-glass fibre
- 43、 D 玻璃纤维 : D-glass fibre
- 44、 S 玻璃纤维 : S-glass fibre
- 45、 玻璃布 : glass fabric
- 46、 非织布 : non-woven fabric
- 47、 玻璃纤维垫 : glass mats
- 48、 纱线 : yarn
- 49、 单丝 : filament
- 50、 绞股 : strand
- 51、 纬纱 : weft yarn
- 52、 经纱 : warp yarn
- 53、 但尼尔 : denier
- 54、 经向 : warp-wise
- 55、 纬向 : weft-wise, filling-wise
- 56、 织物经纬密度 : thread count
- 57、 织物组织 : weave structure
- 58、 平纹组织 : plain structure

- 59、 坏布 : grey fabric
- 60、 稀松织物 : woven scrim
- 61、 弓纬 : bow of weave
- 62、 断经 : end missing
- 63、 缺纬 : mis-picks
- 64、 纬斜 : bias
- 65、 折痕 : crease
- 66、 云织 : waviness
- 67、 鱼眼 : fish eye
- 68、 毛圈长 : feather length
- 69、 厚薄段 : mark
- 70、 裂缝 : split
- 71、 捻度 : twist of yarn
- 72、 浸润剂含量 : size content
- 73、 浸润剂残留量 : size residue
- 74、 处理剂含量 : finish level
- 75、 浸润剂 : size
- 76、 偶联剂 : coupling agent
- 77、 处理织物 : finished fabric
- 78、 聚酰胺纤维 : polyamide fiber
- 79、 聚酯纤维非织布 : non-woven polyester fabric
- 80、 浸渍绝缘纵纸 : impregnating insulation paper
- 81、 聚芳酰胺纤维纸 : aromatic polyamide paper
- 82、 断裂长 : breaking length
- 83、 吸水高度 : height of capillary rise
- 84、 湿强度保留率 : wet strength retention
- 85、 白度 : whiteness
- 86、 陶瓷 : ceramics
- 87、 导电箔 : conductive foil
- 88、 铜箔 : copper foil
- 89、 电解铜箔 : electrodeposited copper foil (ED copper foil)
- 90、 压延铜箔 : rolled copper foil
- 91、 退火铜箔 : annealed copper foil
- 92、 压延退火铜箔 : rolled annealed copper foil (RA copper foil)
- 93、 薄铜箔 : thin copper foil
- 94、 涂胶铜箔 : adhesive coated foil
- 95、 涂胶脂铜箔 : resin coated copper foil (RCC)
- 96、 复合金属箔 : composite metallic material
- 97、 载体箔 : carrier foil
- 98、 殷瓦 : invar
- 99、 箔 (剖面) 轮廓 : foil profile
- 100、 光面 : shiny side

- 101、粗糙面 : matte side
- 102、处理面 : treated side
- 103、防锈处理 : stain proofing
- 104、双面处理铜箔 : double treated foil

#### 四、设计

- 1、原理图 : schematic diagram
- 2、逻辑图 : logic diagram
- 3、印制线路布设 : printed wire layout
- 4、布设总图 : master drawing
- 5、可制造性设计 : design-for-manufacturability
- 6、计算机辅助设计 : computer-aided design. (CAD)
- 7、计算机辅助制造 : computer-aided manufacturing. (CAM)
- 8、计算机集成制造 : computer integrat manufacturing. (CIM)
- 9、计算机辅助工程 : computer-aided engineering. (CAE)
- 10、计算机辅助测试 : computer-aided test. (CAT)
- 11、电子设计自动化 : electric design automation . (EDA)
- 12、工程设计自动化 : engineering design automaton . (EDA2)
- 13、组装设计自动化 : assembly aided architectural design. (AAAD)
- 14、计算机辅助制图 : computer aided drawing
- 15、计算机控制显示 : computer controlled display . (CCD)
- 16、布局 : placement
- 17、布线 : routing
- 18、布图设计 : layout
- 19、重布 : rerouting
- 20、模拟 : simulation
- 21、逻辑模拟 : logic simulation
- 22、电路模拟 : circuit simulation
- 23、时序模拟 : timing simulation
- 24、模块化 : modularization
- 25、布线完成率 : layout efficiency
- 26、机器描述格式 : machine description format . (MDF)
- 27、机器描述格式数据库 : MDF database
- 28、设计数据库 : design database
- 29、设计原点 : design origin
- 30、优化 (设计) : optimization (design)
- 31、供设计优化坐标轴 : predominant axis
- 32、表格原点 : table origin
- 33、镜像 : mirroring
- 34、驱动文件 : drive file
- 35、中间文件 : intermediate file

- 36、 制造文件 : manufacturing documentation
- 37、 队列支撑数据库 : queue support database
- 38、 元件安置 : component positioning
- 39、 图形显示 : graphics display
- 40、 比例因子 : scaling factor
- 41、 扫描填充 : scan filling
- 42、 矩形填充 : rectangle filling
- 43、 填充域 : region filling
- 44、 实体设计 : physical design
- 45、 逻辑设计 : logic design
- 46、 逻辑电路 : logic circuit
- 47、 层次设计 : hierarchical design
- 48、 自顶向下设计 : top-down design
- 49、 自底向上设计 : bottom-up design
- 50、 线网 : net
- 51、 数字化 : digitizing
- 52、 设计规则检查 : design rule checking
- 53、 走 (布) 线器 : router (CAD)
- 54、 网络表 : net list
- 55、 计算机辅助电路分析 : computer-aided circuit analysis
- 56、 子线网 : subnet
- 57、 目标函数 : objective function
- 58、 设计后处理 : post design processing (PDP)
- 59、 交互式制图设计 : interactive drawing design
- 60、 费用矩阵 : cost matrix
- 61、 工程图 : engineering drawing
- 62、 方块框图 : block diagram
- 63、 迷宫 : moze
- 64、 元件密度 : component density
- 65、 巡回售货员问题 : traveling salesman problem
- 66、 自由度 : degrees freedom
- 67、 入度 : out going degree
- 68、 出度 : incoming degree
- 69、 曼哈顿距离 : manhatton distance
- 70、 欧几里德距离 : euclidean distance
- 71、 网络 : network
- 72、 阵列 : array
- 73、 段 : segment
- 74、 逻辑 : logic
- 75、 逻辑设计自动化 : logic design automation
- 76、 分线 : separated time
- 77、 分层 : separated layer



78、定顺序 : definite sequence

## 五、形状与尺寸 :

- 1、导线 (通道) : conduction (track)
- 2、导线 (体) 宽度 : conductor width
- 3、导线距离 : conductor spacing
- 4、导线层 : conductor layer
- 5、导线宽度/间距 : conductor line/space
- 6、第一导线层 : conductor layer No.1
- 7、圆形盘 : round pad
- 8、方形盘 : square pad
- 9、菱形盘 : diamond pad
- 10、长方形焊盘 : oblong pad
- 11、子弹形盘 : bullet pad
- 12、泪滴盘 : teardrop pad
- 13、雪人盘 : snowman pad
- 14、V形盘 : V-shaped pad
- 15、环形盘 : annular pad
- 16、非圆形盘 : non-circular pad
- 17、隔离盘 : isolation pad
- 18、非功能连接盘 : nonfunctional pad
- 19、偏置连接盘 : offset land
- 20、腹 (背) 裸盘 : back-board land
- 21、盘址 : anchoring spur
- 22、连接盘图形 : land pattern
- 23、连接盘网格阵列 : land grid array
- 24、孔环 : annular ring
- 25、元件孔 : component hole
- 26、安装孔 : mounting hole
- 27、支撑孔 : supported hole
- 28、非支撑孔 : unsupported hole
- 29、导通孔 : via
- 30、镀通孔 : plated through hole (PTH)
- 31、余隙孔 : access hole
- 32、盲孔 : blind via (hole)
- 33、埋孔 : buried via hole
- 34、埋/盲孔 : buried /blind via
- 35、任意层内部导通孔 : any layer inner via hole (ALIVH)
- 36、全部钻孔 : all drilled hole
- 37、定位孔 : tooling hole
- 38、无连接盘孔 : landless hole

- 39、 中间孔 : interstitial hole
- 40、 无连接盘导通孔 : landless via hole
- 41、 引导孔 : pilot hole
- 42、 端接全隙孔 : terminal clearomee hole
- 43、 准表面间镀覆孔 : quasi-interfacing plated-through hole
- 44、 准尺寸孔 : dimensioned hole
- 45、 在连接盘中导通孔 : via-in-pad
- 46、 孔位 : hole location
- 47、 孔密度 : hole density
- 48、 孔图 : hole pattern
- 49、 钻孔图 : drill drawing
- 50、 装配图 : assembly drawing
- 51、 印制板组装图 : printed board assembly drawing
- 52、 参考基准 : datum referan